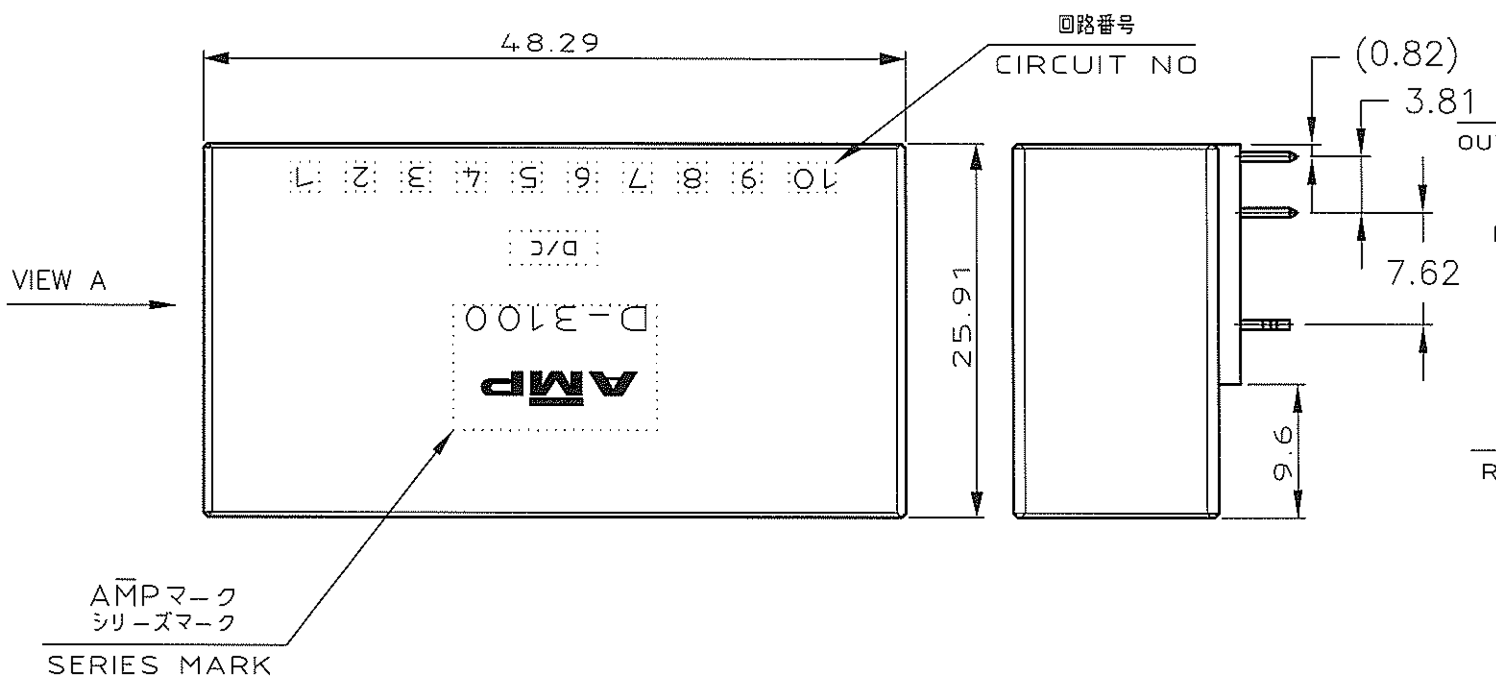
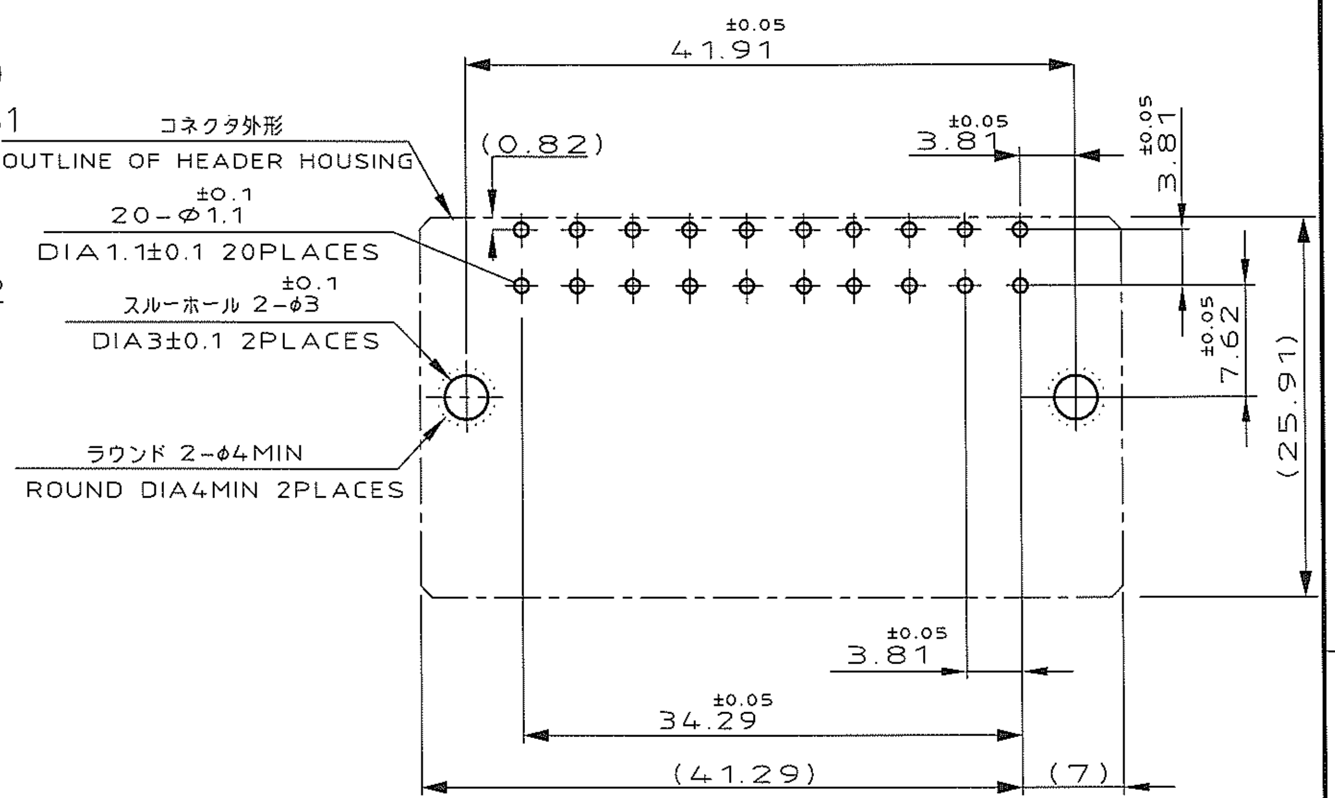
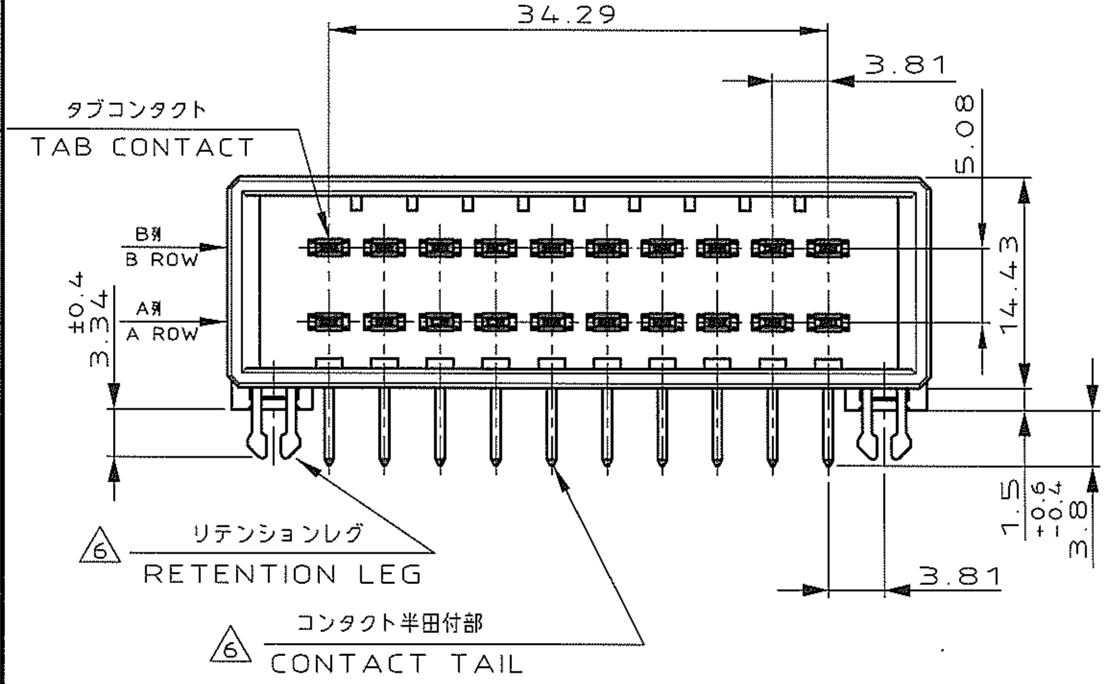
METRIC

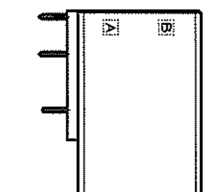
3rd ANGLE PROJECTION

NUMBER 178308









VIEW A
(SCALE:1:1)

推奨基板取付け穴寸法
PC 基板厚:1.6±0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS:1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

1. MATERIAL:HOUSING:GLASS FILED THERMO PLASTIC,POLYESTER COLOR:BLACK
CONTACT:COPPER ALLOY
RETENTION LEG:COPPER ALLOY

2. FINISH(CONTACT AREA):0.38μmMIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING

3. FINISH(CONTACT AREA):0.76μmMIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING

4. FINISH(CONTACT AREA):2.0 μmMIN TIN PLATED OVER NICKEL

~~5. FINISH(RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL~~

6. FINISH(RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注 記

1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性 ポリエステル樹脂 色:黒
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金

2. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部:0.38μm MIN金めっき

3. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部:0.76μm MIN金めっき

4. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部:2.0 μm MINスズめっき

~~5. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部 : ニッケル下地の上に半田めっき~~

6. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
: ニッケル下地の上にスズめっき

6	4	178308-5
6	3	178308-3
6	2	178308-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE
C1	REVISED ECR-07-013273	TS	DM	11JUN 2007
C	REVISED(FJD0-0039-03)	TS	S.M	6/2 '03
B	REVISED(FJD0-0114-03)	TS	SM	25.APR '03
A	REVISED (FJ00-2183-95)	K.I	SM	3/23 '95
0	RELEASED (FJ00-0017-93)	Y.T	S.M	2/8 '93

Copyright © 1993
AMP(Japan) LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.

Tyco Electronics
Tyco Electoronics AMP K.K
Kawasaki,Japan

WIRE RANGE ~~mm²(AWG -)~~	INSULATION DIA ~~- mmΦ~~
MATERIAL SEE NOTE 注記参照	FINISH SEE NOTE 注記参照
DR. 20-JAN-'93 Y.TANAKA	DE. 20-JAN-'93 Y.TANAKA
CHK. 8-FEB-'93 S.MANABE	APP. 8-FEB-'93 S.MANABE

NAME ダイナミック D3100 水平タイプ
20 極 ヘッダーアセンブリー
20 POS DOUBLE ROW
HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	
10以下 :	±0.3
10を超え 30以下 :	±0.4
30を超え100以下 :	±0.45
角 度 :	±3°

SIZE	LOC	NUMBER
A3	J	C-178308

SCALE	REV.	SHEET
2-1	C1	1 OF 1

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J
REV.10/'83

(CUSTOMER DRAWING) 顧 客 用 図 面